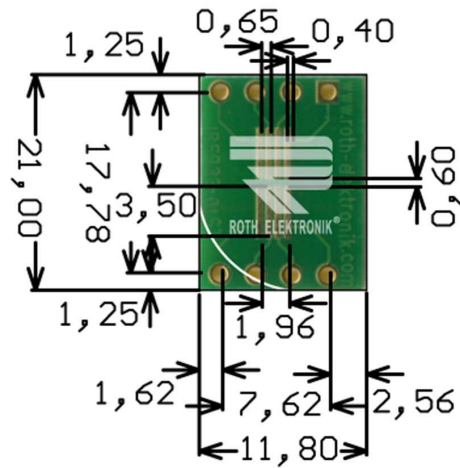


RE933-01ST

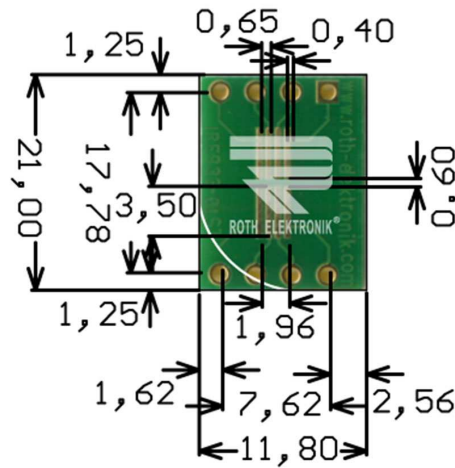
- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Surface chem. Ni/Au with solder stop mask
- Adaption circuit board for TSSOP 8 designed in a single row
- Pitch: 0.65 mm (173 mil)
- Hole diameter 1.00 mm
- Size 11.80 x 15.20 mm



RE933-01ST

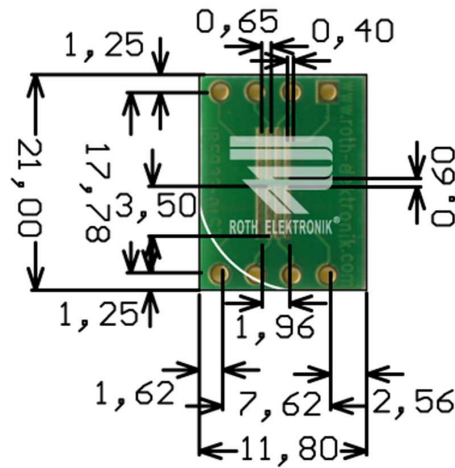
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für TSSOP 8 einreihig ausgeführt
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 11,80 x 15,20 mm

ver.20150130



RE933-01ST

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour TSSOP 8 conçue sur une rangée
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Dimensions 11,80 x 15,20 mm



RE933-01ST

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para TSSOP 8 introducida en una línea
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Tamaño 11,80 x 15,20 mm